

珠海市半导体行业协会

珠半协秘〔2024〕9号

关于组团参加 2024 年深圳国际电子展暨 嵌入式系统展的通知

各有关企业：

为推动我市国家外贸转型升级基地（集成电路）建设，帮助企业开拓国内外市场，提升区域品牌影响力，根据珠海市高新区国家外贸转型升级基地（集成电路）工作站的参展安排，现组织企业抱团参加“2024 深圳国际电子展暨嵌入式系统展”，诚挚邀请贵司参加本次珠海展团。现将有关事项通知如下：

一、展会情况

展会名称：2024 年深圳国际电子展暨嵌入式系统展

展会时间：2024 年 8 月 27 日-29 日

展会地点：深圳会展中心（福田）

二、展品范围

集成电路：GPU/XPU/FPGA/ASIC、MCU/SOC、DSP、RISC-V 等。

嵌入式系统：工业主板/电脑/显示、存储器，通信模组、传

感器，软件系统等。

电源管理/功率器件：功率器件，电源管理器件，信号链器件、电源模块，SiC/GaN 等。

电子元件与供应链：电容/电阻/电感、晶振、继电器、连接器/开关等。

OSAT 封装服务、Chiplet 异构集成产业链专区、3DIC 设计/EDA 工具、IC 载板/玻璃基板、先进材料、半导体制造专用设备

三、展会亮点

2023 年深圳国际电子展暨嵌入式系统展有 545 家展商参与，展出面积 45,000 m²，专业观众达 72,389 人，观众占比上游元件/设备/材料/供应链供应商、半导体制造与封装服务商、AIOT 方案商等 53.79%、终端产品制造商/EMS/OEM/ODM、代理商/经销商/分销商等 36.06%、科研/院校/媒体/KOL/研究机构/政府机构/协会/商会/联盟等 10.15%。2024 年，展会设立“芯、车、碳”三大领域热点主题展示区：AI 与算力、嵌入式设计、车规级芯片、碳中和、SiC/GaN、RISC-V 与开源生态、国产半导体、Chiplet 先进制程等 45,000 m²展区，预计吸引 600+家全球优质品牌厂商、70,000+专业观众，同期举办第八届中国系统级封装大会 SiP China、第二届第三代化合物半导体与应用论坛、第六届中国嵌入式技术大会等 20 余场高峰论坛，展示全球产业动态及未来技术趋势。

四、珠海展团情况

本届深圳国际电子展暨嵌入式系统展协会将组团参加。珠海展团将设立 54 m²特装展位（展位号：1N08），以珠海整体形象参展，突出推介珠海基地内优秀企业和产品。展位面向珠海基地软件和集成电路企业，符合条件的企业可免费入驻珠海公共展位（摊位费、特装费、会刊费和注册费等参展费用全免），费用由协会承担。人员差旅费用企业自理。

五、报名办法

请有意向参展及采购的企业于 2024 年 7 月 26 日 17:00 前填写附件表格以邮件形式发送至协会邮箱：member@zhsia.org.cn。

（注：名额有限，先到先得。请有兴趣的企业抓紧时间报名）

联系人：马岫，联系电话 17377872077

附件：1、境内（外）展会参展报名表（合同书）

2、参展企业及展品信息征集表

3、参展人员信息登记表

珠海市半导体行业协会

2024 年 7 月 01 日

